公司代码：603061 公司简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司 2022 年度的利润分配预案为：以公司实施本次权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
办公地址	上海市青浦区嘉松中路 2188 号	上海市青浦区嘉松中路 2188 号
电话	021-52277906	021-52277906
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）所处行业及确认依据

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）细分子行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），隶属于专用设备制造业（行业代码：C35）。

（二）集成电路行业、集成电路设备行业简介

（1）集成电路行业

半导体本质是一种导电性可受控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角，半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等，发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用于系统实施的全体系的产业；从环节视角，半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系；从功能视角，半导体包括集成电路（Integrated Circuit，简称 IC）和分立器件。集成电路是半导体产业的核心，也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础，也是改造和提升传统产业的核心技术。按其功能、结构的不同，集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试。

公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备，分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节，主要使用的测试设备为探针台和测试机，而在芯片设计验证、成品测试环节，主要使用的测试设备为分选机和测试机。因此，公司所属行业为集成电路行业中的集成电路专用设备行业。

（2）集成电路专用设备行业

专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大，价值量较高。专用设备主要包含前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积（CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备，在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

（3）行业发展情况

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

2022 年以来，国际经济形势复杂多变、消费电子需求趋向放缓，这对半导体封装和测试设备领域带来了一定的压力。

与此同时，受国际贸易格局变化影响，全球半导体产业链正在经历产能布局的调整。短期内，会对半导体封装和测试设备需求带来一定的不确定性。中长期看，半导体产业产能布局的调整及技术升级补缺会在一定程度上促进半导体行业对封装和测试设备的需求。同时，新能源、电动汽车及 AI 运算等相关产业的发展以及国家产业政策的支持也在一定程度上推动半导体封装测试设备领域的发展。

未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保检验质量、效率和稳定性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试程序开发。产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备提出更高要求，测试分选机设备将呈现高速率、稳定性强、柔性化及多功能的发展趋势。各类技术等级设备将并存发展。

（三）报告期内公司从事的业务情况

（1）公司主营业务介绍

公司是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业，属于集成电路和高端装备制造产业，公司深耕集成电路测试分选机领域，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。自公司成立以来，一直专注于全球半导体芯片测试设备领域，同时致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

公司的测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成，可以精准模拟芯片真实使用环境，并实现多工位并行测试，其 Jam rate（故障停机率）低于 1/10,000，可测试芯片尺寸范围可涵盖 2*2mm 至 110*110mm，可模拟最低-55℃、最高 155℃等各种极端温度环境。

公司主要为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

（2）公司主要产品介绍

公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED6000 系列、EXCEED8000 系列、EXCEED9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等；具体如下图：

产品型号	产品图示	技术特点	产品应用
EXCEED-6000C 系列平移式测试分选机		1、可支持最多 8 工位并行测试； 2、可扩展常温、高温、低温（最高可达 -55℃）测试环境。	适配标准测试机，实现测试板、对芯片进行多工位并行测试。
EXCEED-8000C 系列平移式测试分选机		1、可支持最多 16 工位并行测试； 2、可扩展常温（最低可达 -55℃）、常温、高温（最高可达 155℃）测试环境； 3、支持三型上下料盒。	适配标准测试机，实现测试板、对芯片进行多工位并行测试。
EXCEED-9000C 系列平移式测试分选机		1、新高温模式可支持最多 32 工位并行测试；低温模式可支持最多 16 工位并行测试； 2、可扩展低温（最低可达 -55℃）、常温、高温（最高可达 155℃）测试环境以及 ATC 主动控温功能；	适配标准测试机，实现测试板、对芯片进行多工位并行测试。

产品型号	产品图示	技术特点	产品应用
SUMMIT 系列系统级测试分选机		1、可支持最多 16 工位并行测试，每个测试工位上测试系统独立运行； 2、可扩展低温、常温、高温测试环境以及 ATC 主动控温功能； 3、测试完成芯片可分选成最多 17 种类别。	适配以 SoC 为代表的系统级测试机，对多系统级芯片如 CPU、GPU、处理器等进行独立测试。
COLLIE 系列下探测试分选机。		1、为单工位测试； 2、可扩展低温（最低可达 -55℃）、常温、高温（最高可达 155℃）测试环境； 3、预留多类测试接口，可根据客户需求灵活配置。	适配标准测试机或测试板，通常应用于实验室、研究所进行 IP 测试、或小批量生产。
NEOCEED 系列平移式测试分选机		1、可支持最多 16 工位并行测试； 2、可扩展低温（最低可达 -55℃）、常温、高温（最高可达 155℃）测试环境； 3、支持三型上下料盒。	适配标准测试机，实现测试板、可对芯片进行多工位并行测试。

（3）主要经营模式

①盈利模式

公司为客户提供集成电路封装测试专用设备并获取收入和利润。报告期内，公司主营业务收入主要来源于 EXCEED6000 系列、EXCEED8000 系列、其他系列等各类测试分选机产品及相关配件的销售。

②采购模式

公司采购采取询价方式，综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多方面因素选择供应商。公司综合客户订单情况、行业趋势等因素，按照"以销定产"和"安全库存"的形式确定生产计划以及物料需求计划。公司根据每年的供应商交货良率进行评估，结合采购需求及供应商的产品质量和交货能力，与供应商协商询价比选，确定各供应商的采购数量和采购价格等，最终确定采购订单并执行采购。报告期内公司主要供应商保持相对稳定。

③生产模式

公司产品具有较强的定制化属性，公司主要实行"以销定产"和"安全库存"的生产模式，结合库存和市场情况安排生产计划，并采用核心工序自主生产、部分成熟工序委托外协的方式进行生产加工。

④销售模式

公司主要的销售模式有直销模式和代理模式，客户群体主要分布在中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体研发、加工产业发达的国家和地区，其中，境内销售以直销模式为主，境外销售主要有直销和代理模式。对于直销模式与代理模式，主要由公司与终端客户直接签署销售合同。代理模式下，待客户验收设备并支付货款后，公司根据代理协议支付代理商相应佣金。公司具有完善的售后服务体系，公司在境内境外设立了子公司或售后团队负责当地及周边客户的售后工作。

⑤研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及算法类、工艺类等多个方向，研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组分别进行。公司对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了相应规定。研发项目完成立项、审批程序后，形成技术方案；不同研发小组根据技术方案分别进行新产品相关模块的设计，并根据设计完成新产品制造，通过阶段性测试与综合测试之后，进行试生产验证。在实际生产环境测试中，研发小组成员会根据反馈持续完善产品性能，直至新产品正式定型，并投入量产。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	817,116,844.53	612,828,418.01	33.34	381,903,514.92
归属于上市公司股东的净资产	582,738,704.89	426,929,714.91	36.50	271,844,199.46
营业收入	426,018,033.34	420,193,931.25	1.39	185,183,010.80
归属于上市公司股东的净利润	153,931,526.19	153,716,933.23	0.14	56,368,077.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,117,348.26	152,859,409.79	0.17	54,048,503.31
经营活动产生的现金流量净额	67,185,593.93	62,904,236.79	6.81	48,774,991.07
加权平均净资产收益率(%)	30.49	44.00	减少 13.51 个百分点	33.30
基本每股收益(元/股)	3.42	3.42		1.38
稀释每股收益(元/股)	3.42	3.42		1.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	105,964,308.57	105,116,985.75	128,957,490.47	85,979,248.55
归属于上市公司股东的净利润	35,356,461.87	41,431,057.69	46,277,712.30	30,866,294.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,352,695.47	42,371,405.57	45,743,262.44	28,649,984.78
经营活动产生的现金流量净额	-9,577,579.90	37,566,049.13	4,725,235.09	34,471,889.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

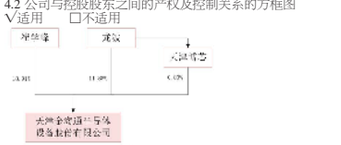
截至报告期末普通股股东总数(户)	17
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,424
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
崔学峰	0	8,511,132	18.91	8,511,132	无	0	境内自然人
上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,369,685	11.93	5,369,685	无	0	其他
龙波	0	5,344,146	11.88	5,344,146	无	0	境内自然人
南通华泓投资有限公司	0	3,958,890	8.80	3,958,890	无	0	境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	3,958,471	8.80	3,958,471	无	0	其他
南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,968,853	6.60	2,968,853	无	0	其他
葛巧珍	0	2,375,082	5.28	2,375,082	无	0	境内自然人
陈佳宇	0	2,359,559	5.24	2,359,559	无	0	境内自然人
杨永兴	0	2,196,931	4.88	2,196,931	无	0	境内自然人
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	0	1,552,341	3.45	1,552,341	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人，崔学峰与龙波为一致行动人； 2、上海瀚岳动投资有限公司作为有限合伙人持有上海金浦、南京金浦的财产份额，上海金浦、南京金浦还拥有共同的合伙人上海烁烟企业管理中心（有限合伙）、上海金浦新潮投资管理有限公司、上海瀚岳动投资有限公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

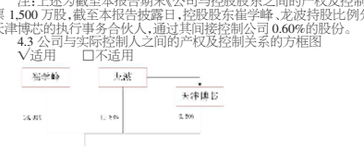
√适用 □不适用



注：上述为截至本报告期末《公司与控股股东之间的产权及控制关系方框图》，因公司公开发行股票 1,500 万股，截至本报告披露日，控股股东崔学峰、龙波持股比例分别为 14.19%和 8.91%，龙波作为天津博芯的执行事务合伙人，通过其间接控制公司 0.60%的股份。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：上述为截至本报告期末《公司与控股股东之间的产权及控制关系方框图》，因公司公开发行股票 1,500 万股，截至本报告披露日，控股股东崔学峰、龙波持股比例分别为 14.19%和 8.91%，龙波作为天津博芯的执行事务合伙人，通过其间接控制公司 0.60%的股份。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 426,018,033.34 元，较上年同期增长 1.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，较上年同期增长 0.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-013

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，母公司实现净利润 152,053,527.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 296,345,295.44 元。

公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），拟分配现金红利合计 15,600,000.00 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 10.13%；不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，公司拟分配的现金红利总额为 15,600,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力集成电路测试设备需要进行持续的研发，从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段，需要投入较高人力成本及研发费用等经常性开支，资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成长阶段，公司将继续专注服务半导体封装测试行业，根据国家政策和战略发展需求，不断加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场，积极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作，时刻把握市场动态，围绕自身技术优势，结合行业发展趋势，持续进行研发创新和技术升级。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，盈利水平较高，公司业务还在持续发展，为保障公司业务发展，公司有较高的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场等，确保公司长期稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司制定的 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。方案的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规，公司最近三年现金分红金额满足《公司章程》以及公司上市后三年的分红回报规划的要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-015

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额：任一时点购买银行理财产品的资金余额不超 5 亿元的总额。

● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

● 履行的审议程序：2023 年 4 月 25 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

（三）资金来源

公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。

（四）实施方式

公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

二、审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在任一时点使用不超过 5 亿元（含本数）的总额度下，以自有资金购买银行理财产品，有效期为自公司 2022 年度股东大会批准之日起 12 个月以内。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全银行理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4、公司财务建立台账对购买的银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。

五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-016

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区沪青平公路 1583 号 N1-016 号夏都小镇新舍汇 F1 上海虹桥诺富特全套房酒店（夏都小镇店）6 楼会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日

至 2023 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）上予以披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603061	金海通	2023/6/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2023 年 6 月 14 日（上午 9:00-11:30；下午 13:00—17:00）

（二）登记地点

地址：上海市青浦区嘉松中路 2188 号证券事务部

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 1）。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在 2023 年 6 月 14 日 17:00 之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系地址：上海市青浦区嘉松中路 2188 号证券事务部

电话：021-52277906

邮箱：jhtdesign@jht-design.com

联系人：刘海龙、蔡亚茹

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

？ 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于 2023 年度财务预算报告的议案》			
4	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》			
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-012

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 04 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 04 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3